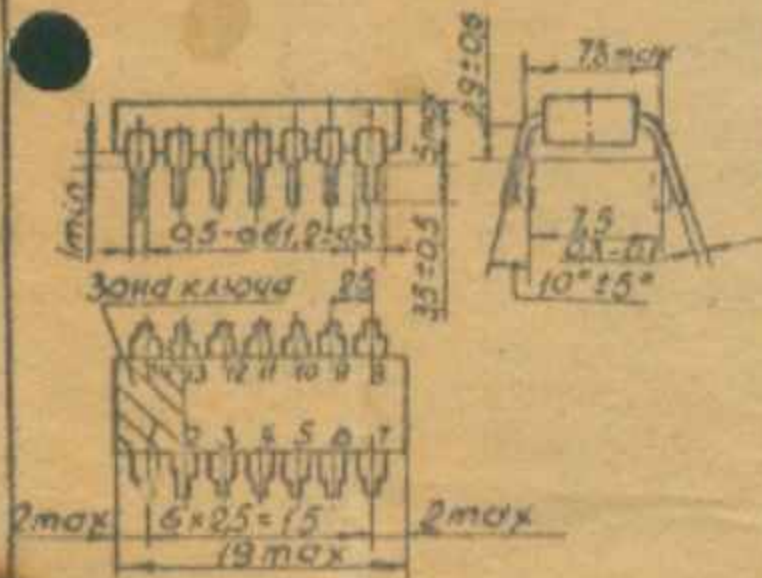


Л11Д

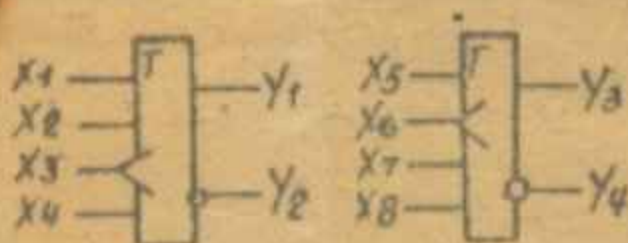
Паспорт.  
Микросхема К1ТК552

Технические условия БКО.348.006 ТУ

Функциональное назначение - два триггера Д



Выход	Назначение
1	Вход установки „0” Y4
2	Вход Д - X2
3	Вход синхронизации X3
4	Вход установки „1” X1
5	Выход Q - Y1
6	Выход Q̄ - Y2
7	Общий
8	Выход Q - Y4
9	Выход Q̄ - Y3
10	Вход установки „1” X5
11	Вход синхронизации Y6
12	Вход Д - X7
13	Вход установки „0” X8
14	Питание E



Время до прихода сигнала	Время после прихода сигнала	
Вход Д	Q	Q̄
0	0	1
1	1	0

Бес микросхемы не более 1г.

Напряжение питания E = +5В ± 5%

Содержание золота в одной микросхеме 0,0056 ± 22,8

Электрические параметры при температуре 120 ± 5°C

Наименование	Номина
Нагрузочная способность, М	10
Выходное напряжение „лог 0” U <sub>0</sub> Вых, в. не более	0,4
Выходное напряжение „лог 1” U <sub>1</sub> Вых, в. не менее	2,4
Максимальная частота деления f <sub>max</sub> МГц не более	10

Предельно-допустимые условия эксплуатации.

Диапазон рабочей температуры от минус 10 до +70 °С.

Предельно-допустимое кратковременное напряжение питания составляет 7В в течение времени 5 миллисекунд.

Срок хранения - 12 лет.

Время гарантийной наработки

Гарантируется соответствие микросхемы требованиям частых технических условий при наработке 1000 часов.

Гарантии исчисляются со дня отгрузки микросхем потребителю.

Указания и рекомендации по эксплуатации.

Кремние микросхемы к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом пайки выводов.

Расстояние от места пайки вывода до корпуса микросхемы должно быть не менее 2,5 мм. Пайку следует производить с принятием мер, исключающих повреждение микросхемы из-за перегрева и механических усилий. При пайке рекомендуется применять припой ПОС-61 ГОСТ 1499-70 флюс ФХСп НО.054.063. При пайке с помощью паяльника последний должен быть обязательно заземлен и иметь мощность не более 60 Вт. При пайке температура не должна превышать 260 °С, а время воздействия этой температуры на микросхему не более 5 сек.

При монтаже руководствоваться указаниями черт. 0308.008 ГЧ

После монтажа микросхема должна быть зашита в соответствии с нормалью НО.054.021 с целью повышения надежности аппаратуры рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру нагрева корпуса микросхемы и защиту от воздействия климатических факторов. При ремонте аппаратуры смену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Дата выпуска

06-76

Штамп ОТК